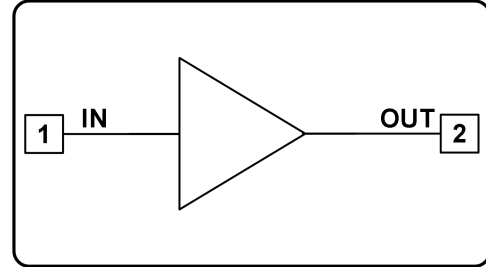




主要特点

- 工作频率: 0.01 –4 GHz
- 增益: 23 dB @ 0.5 GHz
- 噪声系数: 1.4 dB
- 直流供电: +5V @90 mA
- 反向隔离: 27 dB
- P1dB: +21 dBm
- 芯片尺寸: 0.78×0.85× 0.1 mm³

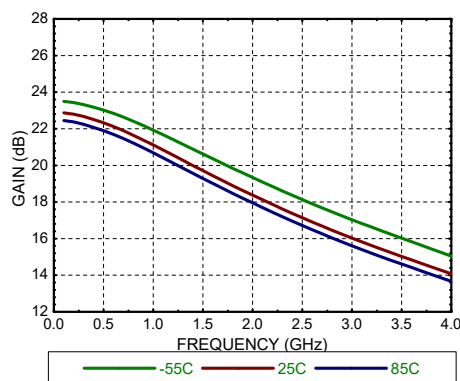
功能框图



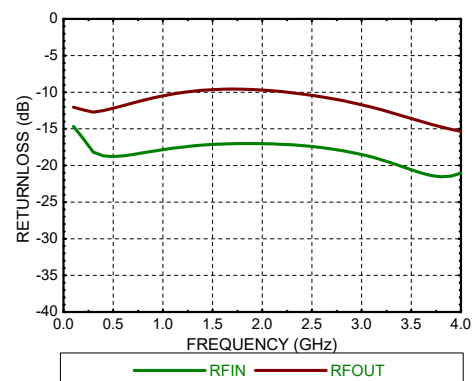
性能指标 ($T_A = +25^\circ\text{C}$, $V_D = +5\text{ V}$, $I_D = 90\text{ mA}$)

参数	最小	典型	最大	单位
工作频段	0.01 - 4			GHz
增益		20		dB
输入回波损耗		15		dB
输出回波损耗		10		dB
反向隔离度		27		dB
输出功率 1dB 压缩点		21		dBm
噪声系数		1.4		dB
输出 IP3		36		dBm
工作电流		90		mA

增益 vs. 温度

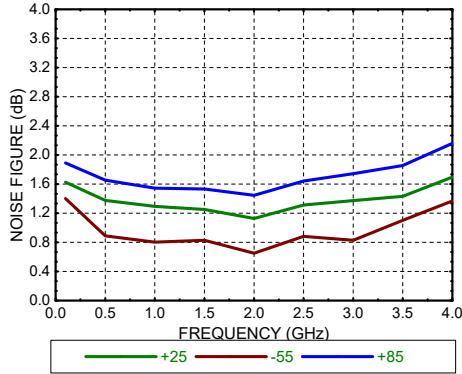


回波损耗

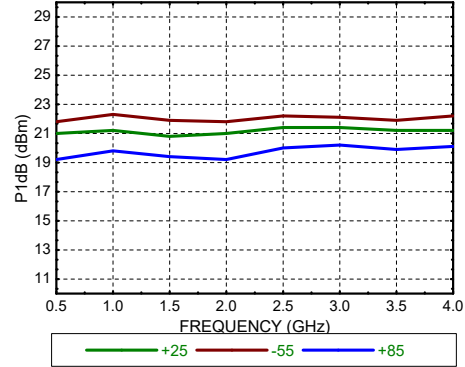




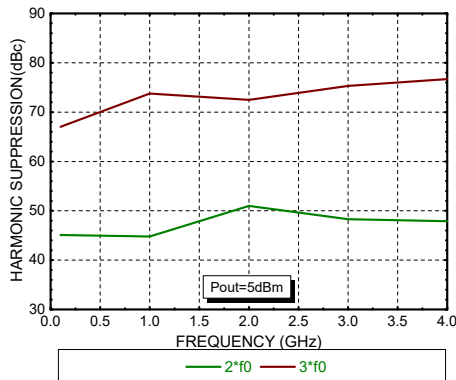
噪声



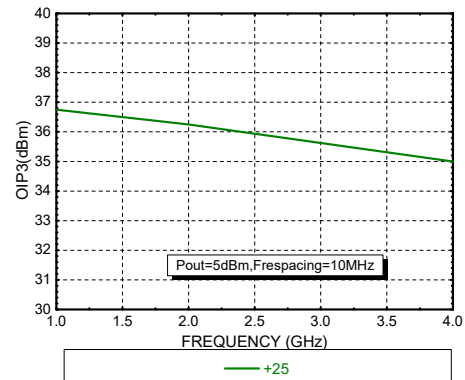
输出功率P1dB



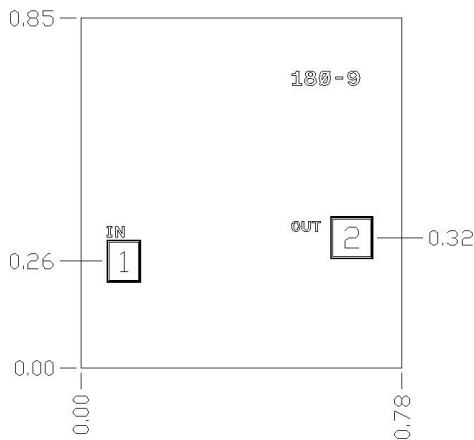
谐波抑制



OIP3



物理参数

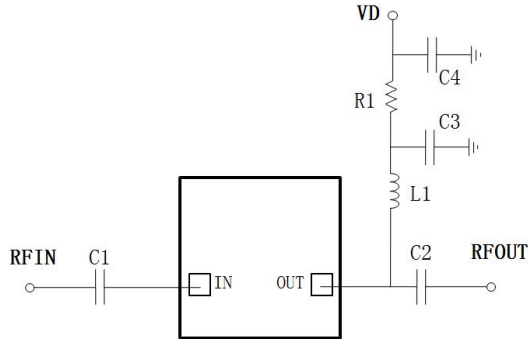


焊盘描述

焊盘序号	功能	描述
1	IN	该焊盘是 DC 耦合，片上无隔直电容，匹配至 50 Ohm
2	OUT	该焊盘是 DC 耦合，片上无隔直电容，匹配至 50 Ohm
芯片背面	GND	芯片背面必须连接至 RF/DC 地



推荐偏置电路



频率	30MHz	100MHz	1GHz	2GHz
L1(nH)	820	270	47	22
C1/C2(pF)	1000	200	20	10
C3/C4(uF)	0.001/0.01			
R1(ohm)	0			

极限参数

射频输入功率: +17 dBm

储存温度: -65~+150°C

输出端口供电: +6V

工作温度: -55~+85°C